

3D SPI 6500 锡膏测厚仪简介

产品名称：锡膏厚度测试仪

产品型号：3D SPI 6500

类 型：半自动 3D 模式

一、产品功能

- 1、友好的编程界面。
- 2、多种测量方式
- 3、扫描间距可调
- 4、形象的 3D 模拟功能
- 5、独立的 3D 动态观察器
- 6、强大的 SPC 功能
- 7、一键回屏幕中心功能
- 8、可测量丝印及铜皮厚度

二、产品特点

1. 采用原装德国进口高清彩色相机，保证测试的高精度和高稳定性。
2. 采用军用级别的二级激光，受外界环境光源干扰小，更加稳定寿命更长。
3. 采用灵活的硬件设计，光源、激光和相机，可对不同颜色的 PCB 板进行测试。
4. 软件分析条件基于数据库，根据分析条件实现预警功能，直观易懂。
5. 强大的报表分析功能，自动生成 R-Chart, X-Bar, 自动计算 CPK。
6. 导出详细完整的 SPC 报表，完全避免手写报表的各种弊端。
7. 软件采用简单实用的理念，侧重于测试的高精度设计，校正块重复精度达到正负 0.001mm。

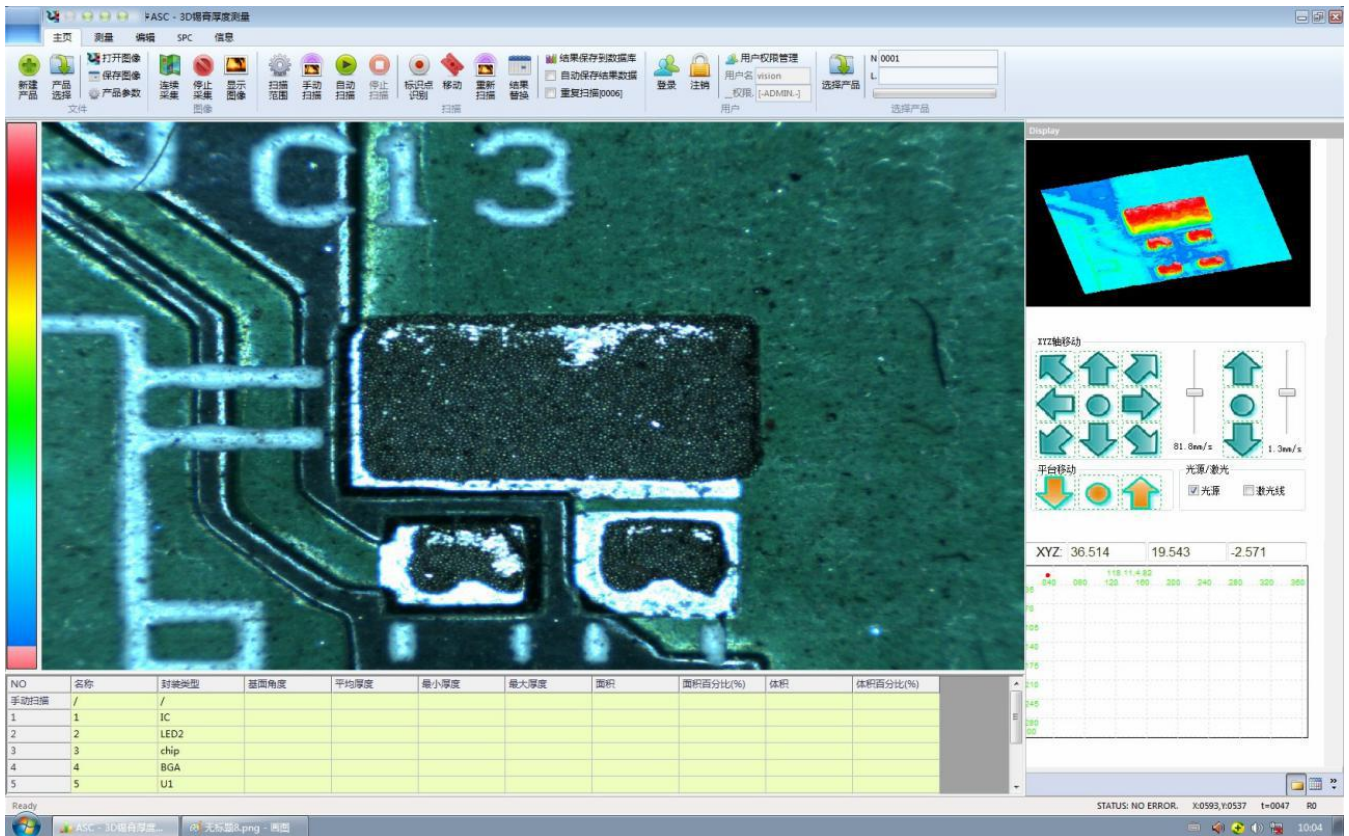
三、产品参数

1. 品牌：美国 ASC
2. 型号：SPI-6500

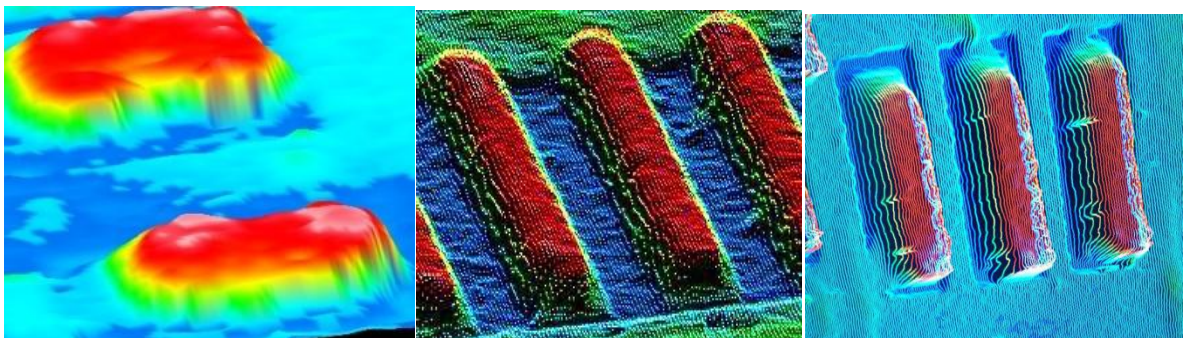
3. 软体语言：简体中文，英文
4. 应用范围：锡膏，红胶，BGA, FPC, CSP 等
5. 测量项目：厚度，面积，体积，平面距离
6. PCB 变形修正：PCB 倾斜角度自动计算，自动修正
7. 聚焦方式：手动对焦
8. 照明光源：白色 LED 模组
9. 测量光源：650nm 低功耗红色激光模组
10. 测量原理：激光 3 角函数法测量
11. Y 轴自动移动范围：60 毫米
12. 精度分辨率：0.1 微米
13. 视场范围(FOV)：15*12 (W*H) 毫米
14. 扫描步距：最小 5 微米 (5 微米/10 微米/15 微米/20 微米)
15. PCB 尺寸：400*400 毫米 (特殊尺寸可定制)
16. 重复测量精度：小于 1 微米
17. 体积重复精度：小于 1%
18. 面积重复精度：小于 1%
19. 允许 PCB 厚度：1~10 毫米
20. 最高测量高度：4 毫米
21. 图像解析度：300 万
22. 测量速度：最高 250 帧/秒
23. 3D 显示方式：点阵列显示，线阵列显示，渲染显示，可任意角度旋转
24. 测量方式：自动全屏测量，框选自动测量，框选手动测量
25. SPC 分析：平均值、最大值、最小值、X-Bar&R 图分析，直方图分析&Ca/Cp/Cpk 输出等。Sigma 自动判断
26. 过程管控：产线，时间，印刷资料，锡膏资料，钢网资料，
27. 操作系统：Windows7 或以上版本
28. 计算机系统：双核 2G 以上，2G 内存，PCI 插槽，USB 接口 3 个，20 吋液晶显示器
29. 设备电源：220V/50/60HZ
30. 设备功耗：300W
31. 设备重量：45 公斤

32. 外形尺寸: L*W*H(400 mm *550 mm *360 mm)

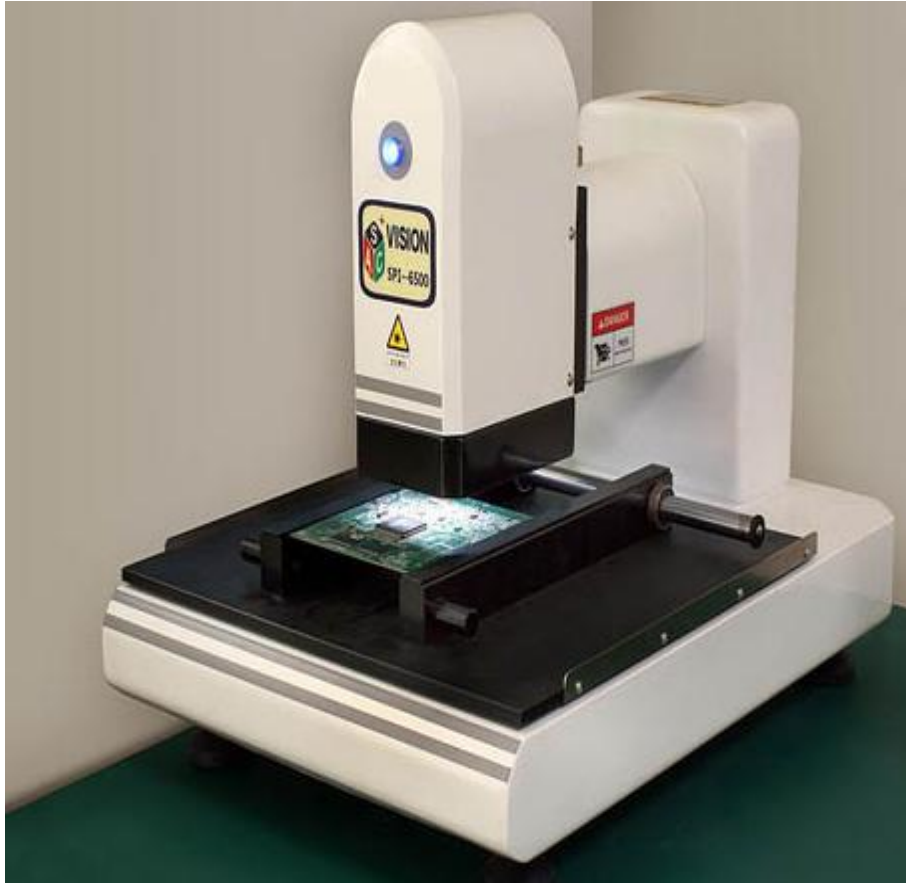
四、产品图片



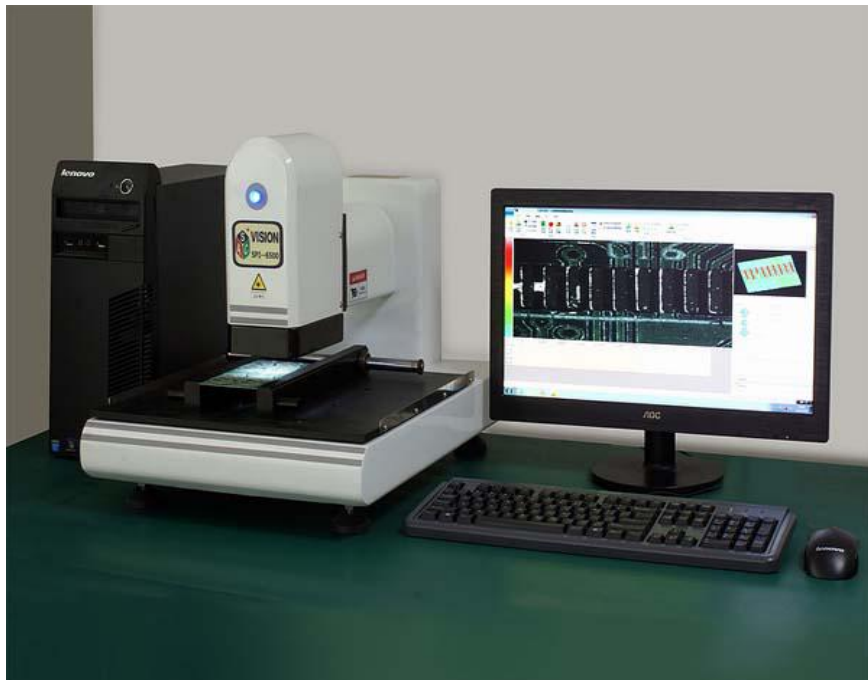
软件界面



3 种不同的 3D 显示模式，再现真实 3D 图像



主机仪器图片



仪器全套图片